砥粒加工学会誌 65巻 12号 / 目次

Journal of the Japan Society for Abrasive Technology (JSAT) Vol.65 No.12 Contents

追 悼	田島琢二様を偲んで 桝田正美	··· 6:
	レーザ援用によるチタン合金の切削加工	0,
	レーリ援用によるデザンロ並の切削加工 杉田直彦, 伊藤佑介, 孫 慧傑	6
	杉田直彦、伊藤阳川、保 意保 である である である である である である である である でき でんしん 超硬合金のミーリング加工	0
特集	も呼込家を利用した起便占金のミーリング加工 後藤昭弘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
	短パルスレーザ電解複合加工による複合構造の創成	04
難加工材の高度	短ハルヘレーリ 电解後 5 加工による後 5 情	G.
加工を実現する	小玉帽平,夏 但 多結晶ダイヤモンド工具を用いた単結晶 SiC の放電・研削複合加工	02
複合加工技術	罗和朗メイドモント工具を用いた単和朗 SIC の放电・断削後6加工 閻 紀旺	C
	切削とダイレスフォーミングを複合した新しい逐次加工技術	0:
	切削とダイレスフォーミングを後占した新しいを次加工技術 二ノ宮進一	61
	/ 吕 进	0
砥粒加工基礎講座	第 12 回 砥石の準備(その 2):ツルーイングとドレッシング《一般砥粒砥石編》	
「砥石」	田代芳章, 岸本 淳	6ţ
研究室紹介	金沢工業大学 精密工学研究室	
17170 <u>—</u> 1471	長岡技術科学大学 結晶工学研究室	66
	株式会社クリスタル光学	66
賛助会員紹介	芝浦機械株式会社	
		00
若手技術者へ	豊かな感性,知恵を磨くことを忘れずに	
贈る言葉	北嶋弘一	66
=^ -	脆弱性と耐酸化性を備えた cBN 粒子含有ダイヤモンド粒子の合成と評価	
	大島龍司, 崔祥仁, 飯塚完司	66
論 文	Binder-free Abrasive Pellet CMG 砥石の開発と性能評価	
	周立波,野田雅人,東瀬大知,尾嶌裕隆,小貫哲平,清水淳,山本武幸	67
会告・その他	専門委員会/分科会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	会報 (公社)砥粒加工学会 関西地区部会報告	
	(公社)砥粒加工学会 北陸信越地区部会 活動報告	
	会告	
	2022 年度 (公社)砥粒加工学会 先進テクノフェア(ATF2022)	68
	(公社)砥粒加工学会 先進テクノフェア (ATF2022)	
	卒業研究発表会の発表募集について	
	先進テクノフェア(ATF2022)「砥粒加工学会推薦企業 : リクルートフェア」の 出展企業 参加募集について	
	出展企業	
	第 50 回 クラインティング・アカテミー	
	ポロンダー	
	著者名索引	
	有日旬未月	05

Journal of the Japan Society for Abrasive Technology (JSAT)

Vol.65 No.12 Contents

	Laser-assisted cutting of titanium alloys	
	Naohiko SUGITA, Yusuke ITO and Huijie SUN	638
Special Issue	Milling of sintered carbide using electrochemical reaction	
Hybrid processing technology or advanced processing of difficult-to-machine materials	Akihiro GOTO ·····	·····642
	Fabrication of hybrid structure by short-pulsed laser and electrochemical machining	
	Shuhei KODAMA and Wataru NATSU·····	646
	EDM/Grinding hybrid machining of single-crystal SiC	
	using poly-crystal diamond tools	
	Jiwang YAN	650
	New sequential processing combining cutting and die-less forming	
	Shinichi NINOMIYA	654
Lecture series on	Preparation of grinding wheels Part 2	
grinding wheel	Yoshiaki TASHIRO and Jun KISHIMOTO	658
	Tosinaki 1710111KO and Juli Kisimiyo To	000
Introduction	Kanazawa Institute of Technology Precision Engineering (PM ⁴) Laboratory ······	660
of Laboratories	Nagaoka University of Technology Crystal Engineering Laboratory	
Corporation members	Crystal Optics Incorporated	·····662
introduction	SHIBAURA MACHINE CO., LTD.	·····663
Dear young	Koichi KITAJIMA ·····	664
generations		
Papers	Synthesis and characterization of high friability	
	and high oxidation resistance diamond abrasives containing cBN particles	
	Ryuji OSHIMA, Xiang Ren CUI and Kanji IIZUKA······	666
	Development and characterization of binder-free abrasive pellet	
	for CMG grinding wheel	
	Libo ZHOU, Masahito NODA, Taichi TOUSE, Hirotaka OJIMA,	
	Teppei ONUKI, Jun SHIMIZU and Takeyuki YAMAMOTO	671
Information	67	$6 \sim 695$

【特集】

難加工材の高度加工を実現する複合加工技術

近年、付加価値の高い製品が求められるなか、材料がますます難加工化する傾向にある、そのため、難加工材に 有効な新たな加工技術が研究されている. 加工技術にはさまざまな原理があり、通常は単一の原理により被加工物 を加工している。しかし、難加工材は単一の加工原理では加工が困難な場合がある。そこで、異なる原理の加工技 術を組み合わせることで、難加工材の加工を可能とする技術が開発されている。本特集では、加工技術を組み合わ せて高度加工を実現する最新の複合加工技術を紹介する.

〔特集 1〕 レーザ援用によるチタン合金の切削加工



【杉田 直彦】(すぎた・なおひこ)

現職:東京大学

専門/業務:生産加工,工作機械

連絡先: 〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1 TEL 03-5841-6336 FAX 03-5841-6336 e-mail: sugi@mfg.t.u-tokyo.ac.jp



【伊藤 佑介】(いとう・ゆうすけ)

現職:東京大学

専門/業務:レーザ加工、レーザ援用切削加工、

超高速イメージングの研究

連絡先: 〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1 TEL 03-5841-6356 FAX 03-5841-6336 e-mail: y.ito@mfg.t.u-tokyo.ac.jp



【孫 慧傑】(そん・けいけつ)

現職:東京大学

専門/業務:レーザ援用切削加工,超高速イ

メージングの研究

連絡先:〒113-8656 東京都文京区本郷7-3-1 TEL 03-5841-6336 FAX 03-5841-6336 e-mail: k.son@mfg.t.u-tokyo.ac.jp

〔特集2〕 電解現象を利用した超硬合金のミーリング加工



【後藤 昭弘】(ごとう・あきひろ) 現職:静岡理工科大学 理工学部機械工学科

教授

専門/業務:電気加工に関する研究開発 連絡先: 〒437-8555 静岡県袋井市豊沢2200-2 TEL 0538-45-0127 FAX 0538-45-0127 e-mail: goto.akihiro@sist.ac.jp

〔特集3〕 短パルスレーザ電解複合加工による複合構造 の創成



【小玉 脩平】(こだま・しゅうへい)

現職:東京農工大学

専門/業務:レーザ加工,微細加工,電解加工 連絡先:〒184-0012 東京都小金井市中町

TEL 042-388-7776 FAX 042-388-7776 e-mail: shuhei-kodama@go.tuat.ac.jp



【夏 恒】(なつ わたる)

現職:東京農工大学 専門/業務:生産加工,電解加工

連絡先:〒184-0012 東京都小金井市中町

2-24-16

TEL 042-388-7776 FAX 042-388-7776 e-mail: summer@cc.tuat.ac.jp

〔特集4〕 多結晶ダイヤモンド工具を用いた単結晶 SiC の放電・研削複合加工



【閻 紀旺】(やん・じわん)

現職:慶應義塾大学 理工学部 機械工学科 専門/業務:超精密加工、マイクロ・ナノ加工 連絡先:〒223-8522 神奈川県横浜市港北区 日吉3-14-1

TEL 045-5661445 FAX 045-5661495

e-mail: yan@mech.keio.ac.jp

切削とダイレスフォーミングを複合した新しい 「特集5] 逐次加工技術



【二ノ宮 進一】(にのみや・しんいち) 現職:日本工業大学 基幹工学部 教授

専門/業務:加工学, 生産工学, 品質工学 連絡先:〒345-8501 埼玉県南埼玉郡宮代町

学園台4-1

TEL 0480-33-7736 FAX 0480-33-7736

e-mail: ninomiya@nit.ac.jp